



2009年3月期 第1四半期資料

2008年8月6日

ワイエイシー株式会社



1. 会社概要



1-1 基本情報

(2007年4月20日現在)

商 号	ワイエイシイ株式会社
証券コード	6298 (東証1部)
設 立	1973年 (昭和48年)年5月
代 表 者	代表取締役社長 百瀬武文
事業所等	本 社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、福岡、大分、昭島、新竹（台湾）、上海（中国） 工 場：昭島、山梨、熊本
子 会 社	ワイエイシイ新潟精機株式会社（新潟県妙高市） HYAC Corporation（米国） YAC Systems Singapore Pte Ltd（シンガポール）
資 本 金	2,756百万円
事業内容	産業用エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の開発・製造・販売
決 算	3月31日



1-2 当社の主力製品

▲ハードデスク関連

- ・バニッシャー装置
- ・ワイピング装置
- ・クリーンコンベア

▲液晶関連

- ・プラズマ・ドライ・エッチング装置
- ・プラズマ・ドライ・アッシング装置

▲半導体関連

- ・ロジック系IC用テストハンドラー

▲クリーニング関連

- ・自動包装機
- ・ワイシャツ仕上機
- ・アパレル

▲新規事業

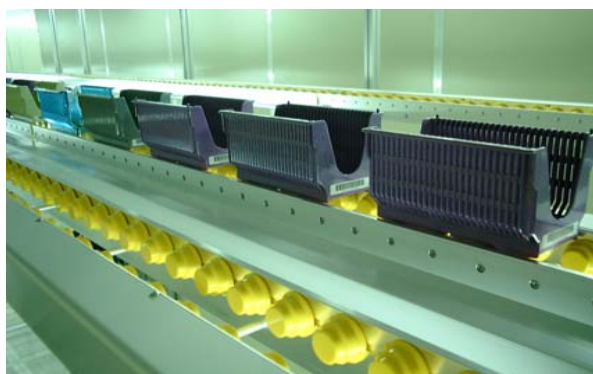
- ・FEL関連

<ハードディスク関連製品>

バニッシャー	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
ワイピング	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーティクルの除去及び潤滑財を表面に均一にする装置
クリーンコンベア (HD工場向け)	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベアAGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ、搬送効率が高い。
クリーンコンベア (半導体工場向け、 太陽電池工場向け)	(同上)但し、半導体向けは搬送物が300mm用ウエハポット、太陽電池はガラス基板又は約5"ウエハーが入ったカセットで、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される。
クリーンコンベア (液晶工場向け)	(同上)但し、搬送物はパネルサイズに切りだされた基盤を搬送する、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される。



バニッシャー



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用クリーンコンベア

<液晶関連製品>

プラズマ・ドライ・エッチング
装置

液晶ディスプレイの各セルの液晶整列方向を個々に制御する微小トランジスターをガラス基板上に描画するプロセスで用いる。
フォトマスクを通して露光した結果、硬化した部分以外を除去後、露出した薄膜をプラズマを利用してガス化し除去する装置。



第7世代用プラズマ・ドライ・エッチング装置(3チャンバータイプ)

対応
基板サイズ

G2
G4
G4.5
G5
G5.5
G6
G7
G7.5
G8

<半導体関連製品>

ロジック系IC用
ICテストハンドラー

ICのパッケージング後の検査工程で、テスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づき、ICを良品と不良品に自動選別する装置。
必要に応じて、精度の高い高温・低温(-55°C~155°C)下でのテストも行う。



ICテストハンドラー(4個同時測定・常温タイプ)



新製品 ICテストハンドラー(16個同時測定・常・高温タイプ)

<クリーニング関連製品>

ボディープレス機せ	シャツを前後から熱版ではさみシャツのボディー部をプレスする装置。 胴立を2つもち、プレス中に次のシャツを装填できるダブルタイプと、胴立がひとつのシングルタイプがある。 またプレス完了のシャツを自動でハンガーの掛けるオートキャリー付のタイプもあり。
タック・スリーブプレス機	シャツのタック部・袖部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
カラー・カフスプレス機	シャツの襟部・カフス部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
包装機	クリーニング完了後の衣類にカバーフィルムを自動で装填する装置。 ハンガーのままカバーする立体タイプとたたんだ状態でカバーする平面タイプがある。
アパレル関連機械	洋服の生産工程、縮絨機(生地を蒸気で安定化させる)、芯地・接着機(裁断後の生地を張り合わせる) プレス仕上げ機(完成商品のシワを取り成型する)



シャツ用ボディープレス機
(Wタイプ・オートキャリー付)



包装機 (立体タイプ)



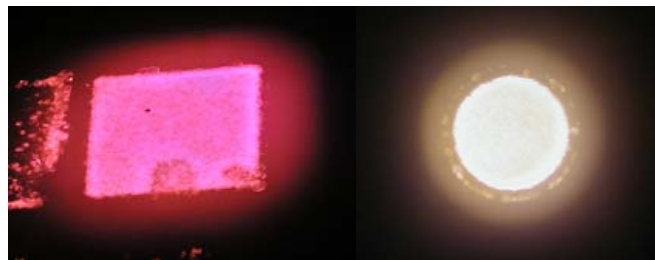
縮絨機



仕上げ機

<新規事業・FEL>

ナノダイヤモンド薄膜製造	<p>金属等の材料の表面にナノダイヤモンドの薄膜を生成したエミッターを製作。</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none">・従来の蛍光灯と異なり、水銀・鉛等の有害物質を使用しない。・LED(発光ダイオード)に比べ発光効率が高く省エネ効果がある。・蛍光灯に比べ長寿命である。・蛍光灯、LEDに比べ発熱量が少ない。・色合成の自由度が高い。
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



発光写真



2. 決算の概要



1 決算のハイライト(連結)

(単位:百万円)

科目	2006年 3月期 第1四半期	2007年 3月期 第1四半期	2008年 3月期 第1四半期	2009年 3月期 第1四半期	前年比 増減額	前年比 増減率(%)
売上高	3,139	4,933	4,586	3,876	▲710	▲15.5%
営業利益	305	789	1,065	281	▲784	▲73.6%
経常利益	320	763	1,077	205	▲872	▲80.9%
当期利益(四半期)	203	418	695	118	▲577	▲83.0%
1株当たり当期利益 (四半期)	23.7	44.4	72.1	12.8	▲59.3	▲82.2%
営業利益率	9.7%	16.0%	23.2%	7.2%	—	—
研究開発	—	—	—	74	—	—
設備投資額	—	—	—	6	—	—
減価償却実施額	—	—	—	43	—	—



2 事業別売上金額(連結)

(単位:百万円)

科目	2006年 3月期 第1四半期	2007年 3月期 第1四半期	2008年 3月期 第1四半期	2009年 3月期 第1四半期	前年比 増減額	前年比 増減率(%)
メモリーディスク関連	1,424	1,888	2,667	939	▲1,728	▲ 64.7%
液晶関連	1,160	2,448	1,411	2,105	694	49.1%
半導体関連	253	322	126	405	279	221.4%
クリーニング関連	301	275	381	425	44	11.5%
FEL	—	—	—	0	—	—
合計	3,139	4,933	4,586	3,876	▲710	▲ 15.4%



3 事業別受注・受注残金額(連結)

(1) 受注金額(連結)

科目	2009年 3月期 第1四半期
メモリーディスク関連	828
液晶関連	4,827
半導体関連	470
クリーニング関連	(425)
FEL	0
合計	6,126 (注1)(6,551)

(2) 受注残金額(連結)

2009年 3月期 第1四半期
751
11,650
466
(注2) —
0
12,867

(単位:百万円)

(注1) カッコ内はクリーニング関連を含みます。

(注2) クリーニング関連は、販売計画に基づいた見込生産を行っておりますので除外しております。



3.当社を取巻く事業環境と 2009年3月期の予想及び 第10次中期計画の概要

第9次中期計画の基本戦略

I T産業の特徴

1. 高成長 2. 競争激化 3. 高スピード（技術革新） 4. 市場変動（大きい）



この事業環境における安定的収益確保

ワイエイシイの基本戦略

1. 高収益企業への挑戦	<ul style="list-style-type: none"> ・ オンリーワン技術の強化（差別化） ・ 依命システムの徹底 ・ 低コスト経営の徹底 ・ モチベーションの一層の高揚
2. マーケット深耕	<ul style="list-style-type: none"> ・ 顧客との強固な信頼関係構築による市場ニーズの先取りにより新製品バージョンUPによる差別化、取扱製品の増加
3. ファブレス経営の徹底	<ul style="list-style-type: none"> ・ 営業、開発、技術、アフターサービスを中心とした経営体制 ・ 市場変動による経営リスクの最小化
4. カスタマー・サポートの充実	<ul style="list-style-type: none"> ・ 顧客との強固な信頼関係構築による当社純正修理部品の利用推進と消耗品の拡大
5. M&A、アライアンス	<ul style="list-style-type: none"> ・ シェアUPとシナジー効果による事業拡大
6. グローバル経営	<ul style="list-style-type: none"> ・ グローバル化の更なる拡大
7. 環境対応	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当社製品の環境への対応



3-1 事業環境(設備動向)

<ハードディスク市場>

- ドライブの需要は引き続き年率15%の上昇が予想されてるが、業界再編の影響が上期までつづくと思われる。
- 次世代高密度デスク用の設備装置の開発

◎ 前年比 20%マイナス成長を予想

<液晶パネル市場>

- 年内は大型(TV用)、小型パネル(携帯端末)ともに需要が拡大すると思われる。
- 2011年の地上波デジタル放送本格稼働までは積極的な設備投資の継続が予想される

◎ 前年比同等の成長を予想



3-1 事業環境(設備動向)

<半導体市場>

- 今年度は後工程の需要が増加すると思われる。
 - ◎ 前年比 45%のプラス成長を予想

<クリーニング市場>

- 国内での市場は安定。海外需要は拡大すると思われる。
- 社内での製販一体化による合理化を図る。
 - ◎ 前年比 20%のプラス成長を予想

<FEL市場>

- テストサンプル提供、来期には事業化へ



3-2 事業別の課題と今後の取組み

事業区分	現 状	課 題	現在・今後取組み
ハードディスク 関連事業	■ バニッシャーでは国内・ 外で約80%のシェア ■ マーケットリーダー	■ バニッシャー、ワイピン グ市場シェアの拡大	■ 両機種とも世界シェア100% を目指す（高スループット 化、省スペース化）
		■ 次世代メディア（高密度） 装置の開発	■ 主要お客との連携により 開発
		■ デスク、半導体・液晶・ 太陽電池用コンベアの 拡販	■ 海外も含めたコスト低減
		■ 消耗品の拡販	■ ワイピング用消耗品の拡大 ■ 新素材の開発
液晶関連事業	■ プラズマ・ドライ・エッチン グでは市場シェア25%	■ 市場シェアの拡大	■ 競合製品との差別化 オンリーワン技術の確立
		■ 粗利率の向上	■ 徹底したコストダウン設計と コスト管理 ■ 協力会社との連携強化
		■ 新事業装置の開発	■ プラズマを使用した新規装 置



3-2 事業別の課題と今後の取組み

事業区分	現 状	課 題	現在・今後取組み
半導体 関連事業	<ul style="list-style-type: none">■市場シェア5%■特定顧客との関係は強固	<ul style="list-style-type: none">■第3、第4の特定顧客の確保■新製品の投入<ul style="list-style-type: none">・高生産能力・高安定性・環境対応	<ul style="list-style-type: none">■特定顧客確保に集中■主力製品のバージョンアップ■新製品機種の販売
クリーニング 関連事業	<ul style="list-style-type: none">■業界でのブランド力は強固■包装機国内シェア約90%■仕上機国内シェア約50%■アパレル	<ul style="list-style-type: none">■シェアアップ■海外売上の拡大■消耗品の販売拡大■粗利率の向上	<ul style="list-style-type: none">■代理店の再構築■製販一体化によるコスト低減■米国、中国、ヨーロッパへの拡大■環境対応機
FEL 関連事業	<ul style="list-style-type: none">■ランプメーカーへサンプル出荷	<ul style="list-style-type: none">■生産技術の向上■品質管理の向上	<ul style="list-style-type: none">■製品の安定化■製品のコストダウン■量産技術の確立



3-3 2008年度通期計画(連結)

単位 百万円

科目	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期 (見込)		対前年 増減額 (見込)	対前年比 増減率(%) (見込)
				(上期)	(通期)		
売上高	18,050	22,424	21,198	8,000	19,500	▲1,698	▲8.0%
営業利益	2,495	3,676	2,295	600	1,900	▲395	▲17.2%
経常利益	2,401	3,583	2,371	500	1,850	▲521	▲21.9%
当期純利益	1,504	2,103	1,524	300	1,150	▲374	▲24.5%
1株当たり当期純利益(円)	167.8	219.1	158.1	32.3	123.7	▲34.4	▲21.8%

注:平成20年8月6日業績修正後の数値です



3-4 事業別売上金額(連結)

単位 百万円

科目	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期 (見込)		対前年 増減額 (見込)	対前年比 増減率(%) (見込)
				(上期)	(通期)		
メモリーディスク関連	6,812	9,899	7,039	1,520	5,220	▲1,819	▲25.8%
液晶関連	8,526	9,400	10,919	4,580	10,110	▲809	▲7.4%
半導体関連	1,192	1,404	1,093	910	1,710	617	56.5%
クリーニング関連	1,522	1,721	2,146	990	2,460	314	14.6%
FEL関連	—	—	—	0	0		
売上合計	18,050	22,424	21,198	8,000	19,500	▲1,698	▲8.0%

注:平成20年8月6日業績修正後の数値です



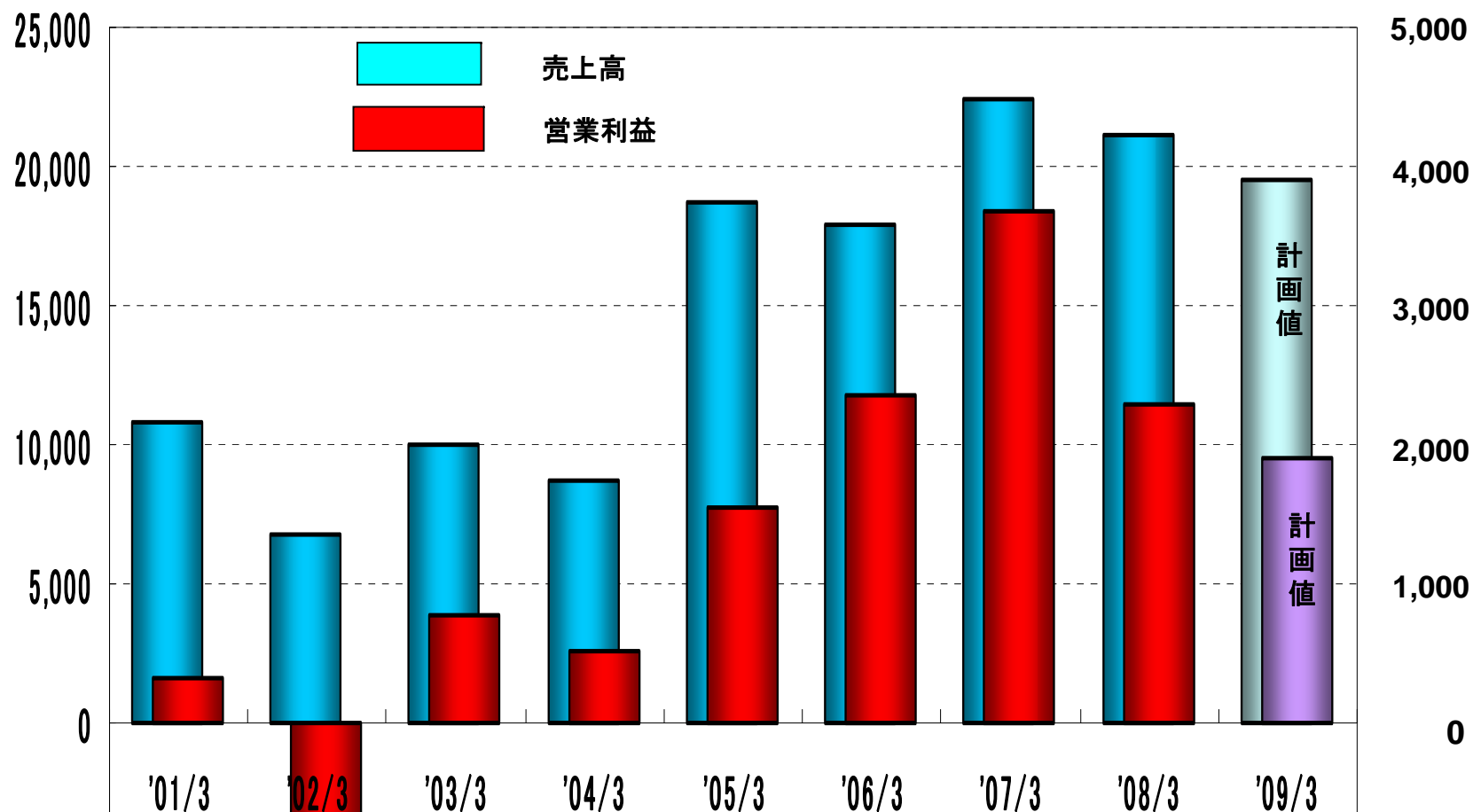
3-5 業績推移と第9次中期計画 (連結)

売上高

売上・営業利益実績

百万円

営業利益



第7次中期計画

V字回復

第8次中期計画

優良企業復活

第9次中期計画

高収益企業挑戦

第10次中期計画

(10月完成予)



業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予数値と異なる可能性があります。

ワイエイシイ株式会社